

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **SOP3C-8PIN / Halogen free**

JEITA Package name; **(P-LSOP08-04.40x05.00-1.27)**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.077 [g] ≈1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content	*Note2	Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	4.0	シリコン	7440-21-3	4.0	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.000008	2	ドーバント
			無機リン	7723-14-0	0.00002	5	ドーバント
			アルミニウム	7429-90-5	0.00008	20	配線材
			ヒ素 ≈3	7440-38-2	0.00002	5	ドーバント
			フッ素 ≈3	7782-41-4	0.000008	2	ドーバント
			チタン ≈3	7440-32-6	0.00008	20	配線材
			モリブデン ≈3	7439-98-7	0.00008	20	配線材
			タングステン ≈3	7440-33-7	0.0001	30	配線材
			コバルト ≈3	7440-48-4	0.000008	2	配線材
パッケージ	保護膜	0.079	ポリイミド	-	0.079	1000000	保護膜 ≈4
	ダイアタッチ材	0.15	銀	7440-22-4	0.12	822222	主成分
			エポキシ樹脂	-	0.022	144444	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.005	33333	接着剤
	端子メッキ	0.69	錫	7440-31-5	0.67	975000	鉛フリーはんだ
			銀	7440-22-4	0.017	25000	鉛フリーはんだ
	リードフレーム	19	ニッケル	7440-02-0	8.4	430000	導体材
			鉄	1309-37-1	11.0	565000	導体材
			銀	7440-22-4	0.1	5000	インナーリードメッキ
	ボンディングワイヤー	0.10	金	7440-57-5	0.10	1000000	導体材
	モールド樹脂	53	エポキシ樹脂	-	4.7	90000	主成分
			フェノール樹脂	-	1.6	30000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	44.1	839000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.16	3000	樹脂着色剤
			有機リン化合物	-	0.42	8000	硬化促進剤
			金属水酸化物	-	1.6	30000	樹脂難燃剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。